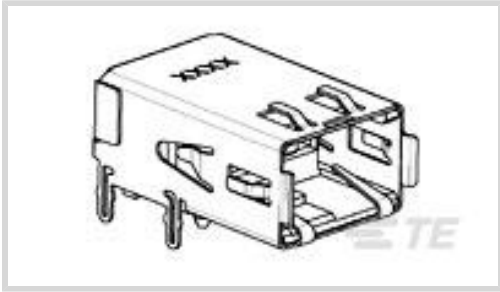




TE 内部编号 1888372-1
HSSDC2 Connector Receptacle, Surface Mount, Cable-to-Board, 7
Position, 1.27 mm [.05 in] Centerline, Printed Circuit Board, Signal,
Board Mount
[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 音频和视频连接器 > HSSDC2 连接器



连接器和壳体类型: 母端
PCB 端接方法: 表面贴装
连接器系统: 缆到板
位数: 7
中心线（间距）: 1.27 mm [.05 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端
连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

托架数	1
PCB 固定位置	外壳上
位数	7

接触件特性

端子底板材料	镍
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	铜合金
端子接合区域电镀材料厚度	1.27 μm[50 μin]
端子额定电流（最大值）	.5 A

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

PCB 安装固定类型	板锁
PCB 安装固定	带有



连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

外壳材料	LCP
中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]

使用环境

工组温度范围	-10 – 60 °C[14 – 140 °F]
--------	--------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	卷带包装
------	------

产品合规性

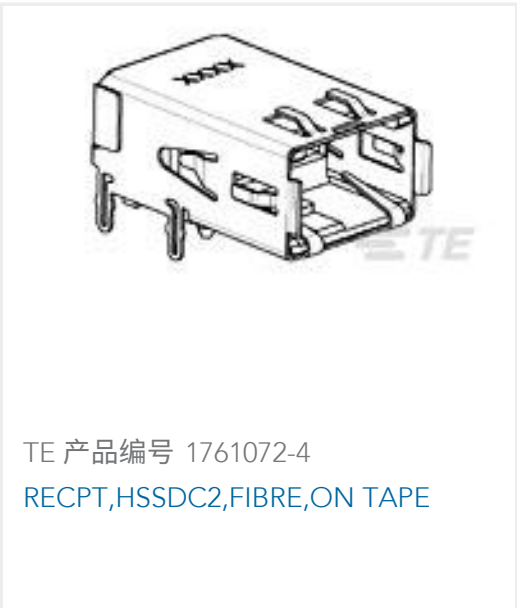
如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

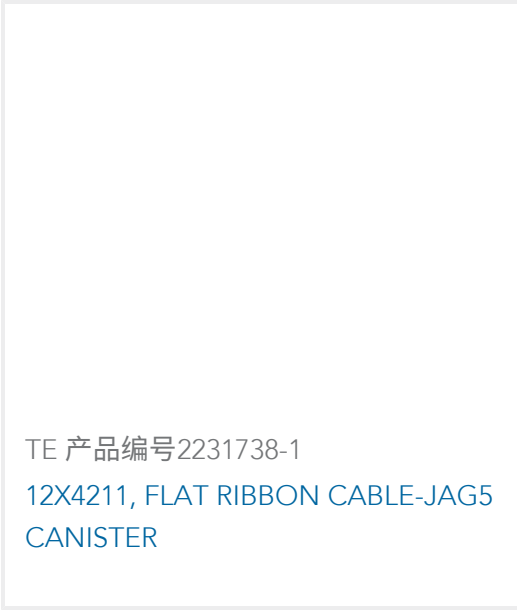
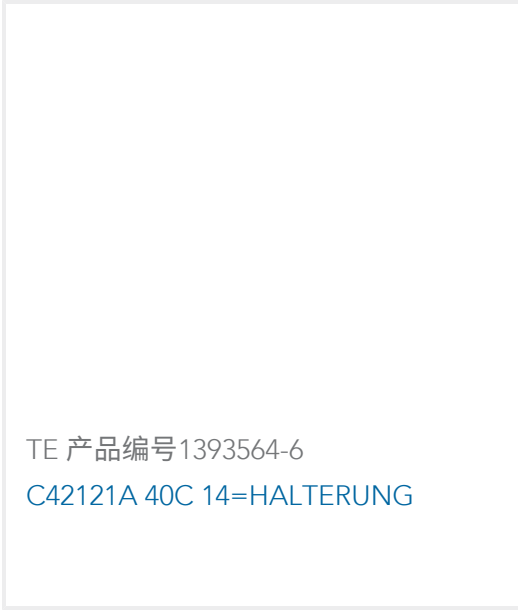
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



文档

产品图纸

RECPT,HSSDC2,FIBRE,ON TAPE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1888372-1_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1888372-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1888372-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本